

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据2026年1-5月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元（增加预计总额度1.4亿元）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（其中关联董事吴华先生回避表决）。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》

(公告编号：2026-046)。

本议案审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

### (二) 审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟在此前已审议通过的综合授信额度的基础上，增加不超过等值人民币 8 亿元（含 8 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。本次增加后，公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度合计总额不超过等值人民币 14 亿元（含本次新增额度，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）。

上述额度在授权期限内可以循环使用，公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 1 月 19 日止。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保，具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

### (三) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日